

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1

(由92巷進入)

郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱

精材科技股份有限公司服務代理人

台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部

台新銀行網址：[www.taishinbank.com.tw](http://www.taishinbank.com.tw)

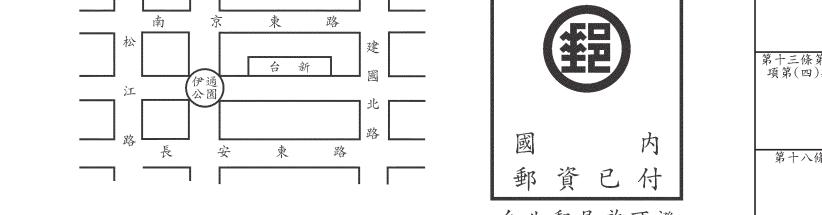
電話：(02)2504-8125(分機：6301~6306)

語音查詢專線：(02)2516-9990公司代號：210

證券代號：3374

營業時間：  
星期一～星期五  
上午9:00～下午5:00

公車站名：建國北路口  
306、307、604、672、  
282、292、266、棕9



國內郵資已付

台北郵局許可證

臺北字第580號

印 刷 品

無法投遞無需退回

股東 台啓

(附件七) 審查係保作業程序修訂前後對照表

序號

現行條文

修訂後條文

修訂原因

增訂審計委員會

相關規定

第一條

現行條文

修訂後條文

修訂說明

增訂審計委員會

相關規定

第二條

現行條文

修訂後條文

修訂說明

增訂審計委員會

相關規定

第三條

現行條文

修訂後條文

修訂說明

增訂審計委員會

相關規定

第四條

現行條文

修訂後條文

修訂說明

增訂審計委員會

相關規定

第五條

現行條文

修訂後條文

修訂說明

增訂審計委員會

相關規定

第六條

現行條文

修訂後條文

修訂說明

增訂審計委員會

相關規定

第七條

現行條文

修訂後條文

修訂說明

增訂審計委員會

相關規定

第八條

現行條文

修訂後條文

修訂說明

增訂審計委員會

相關規定

第九條

現行條文

修訂後條文

修訂說明

增訂審計委員會

相關規定

第十條

現行條文

修訂後條文

修訂說明

增訂審計委員會

相關規定

第十一條

現行條文

修訂後條文

修訂說明

增訂審計委員會

相關規定

第十二條

現行條文

修訂後條文

修訂說明

增訂審計委員會

相關規定

第十三條

現行條文

修訂後條文

修訂說明

增訂審計委員會

相關規定

第十四條

現行條文

修訂後條文

修訂說明

增訂審計委員會

相關規定

第十五條

現行條文

修訂後條文

修訂說明

增訂審計委員會

相關規定

第十六條

現行條文

修訂後條文

修訂說明

增訂審計委員會

相關規定

第十七條

現行條文

修訂後條文

修訂說明

增訂審計委員會

相關規定

第十八條

現行條文

修訂後條文

修訂說明

增訂審計委員會

相關規定

第十九條

現行條文

修訂後條文

修訂說明

增訂審計委員會

相關規定

第二十條

現行條文

修訂後條文

修訂說明

增訂審計委員會

相關規定

第二十一條

現行條文

修訂後條文

修訂說明

增訂審計委員會

相關規定

第二十二條

現行條文

修訂後條文

修訂說明

增訂審計委員會

相關規定

第二十三條

現行條文

修訂後條文

修訂說明

增訂審計委員會

相關規定

第二十四條

現行條文

修訂後條文

修訂說明

增訂審計委員會

相關規定

第二十五條

現行條文

修訂後條文

修訂說明

增訂審計委員會

相關規定

第二十六條

現行條文

修訂後條文

修訂說明

增訂審計委員會

相關規定

第二十七條

現行條文

修訂後條文

修訂說明

增訂審計委員會

相關規定

第二十八條

現行條文

修訂後條文

修訂說明

增訂審計委員會

相關規定

第二十九條

現行條文

修訂後條文

修訂說明

增訂審計委員會

相關規定

第三十條

現行條文

修訂後條文

修訂說明

增訂審計委員會

相關規定

第三十一條

現行條文

修訂後條文

修訂說明

增訂審計委員會

相關規定

第三十二條

現行條文

修訂後條文



民國九十九年營業報告書

歷經了過去兩年經濟急遽升化之衝擊與全球化的挑戰，如何因應市場需求的快速變遷成為企業最重要的課題。本公司除持續開發晶圓級封裝技術以繼續保持先進光學感測器產品封裝市場之領先地位之外，更積極將晶圓級封裝技術推展至下世代電子產品應用領域包括高功率節能元件封裝、微機電(MEMS)、矽基載板等產品，以符合市場需求；同時加速與整合元件客戶進行先進晶圓級封裝技術的合作及製造服務，以擴大並確保本公司在晶圓級封裝製程技術的領先優勢。

## 經營實績

本公司民國九十九年全年營收為新台幣 3,962,254 千元，較前一年營收 2,354,536 千元增加 68%；稅後淨利為新台幣 505,260 千元，較前一年稅後淨利 10,597 千元大幅增加，每股盈餘為新台幣 2.22 元。

## 企業發展

為持續拓展公司業務及產能擴充以滿足客戶中長期需求，本公司於民國一百年一月十四日臨時董事會決議，購置桃園中壢工業廠房。

為維繫公司的長遠發展與持續成長動能，本公司自民國九十七年起陸續與各 IC 設計或製造公司合作開發多項創新晶圓級封裝技術，包括晶圓薄化、電極製程以及先進矽穿孔封裝等，著眼於提供短、小、輕、薄之高密度封裝解決方案，以符合下一世代可攜式電子產品封裝之需；產品應用範圍包括手機、筆記型電腦、平板電腦以及消費性電子等市場。產品則由光學感測器元件擴展至功率節能元件、功率場效電晶體與微機電產品，該研發成果已陸續貢獻於本年度營收。

## 技術與創新

持續強化先進技術的研發與精進製造技術是維持本公司產品競爭力的不二法門，同時有助於協助客戶佈局新產品並爭取市場商機。民國九十九年除了順利完成應用於先進光學感測器元件的矽穿孔(Through-Silicon Via，簡稱 TSV)封裝技術開發，同時順利量產功率元件所需之晶圓薄化與電極製程服務。未來本公司將持續更多新核心技術的開發與應用，例如矽穿孔封裝在各式感測器元件的應用，並不斷探索各種技術與策略合作的機會，例如三維晶片封裝技術(3D IC package)，以拓展公司的營運績效與成長動能。

## 前景與展望

展望民一百年，除加強先進光學封裝技術的開發以擴大影像感測器於高階手機市場的佔有率外，並逐步推廣至筆記型電腦以及各式手持裝置等用途。同時將以更具競爭優勢的晶圓級相關封裝服務創新，將產品線擴展至功率場效電晶體、電源控制以及類比元件、微機電(MEMS)、矽基載板等產品，以分散單一產品的風險並奠定公司未來成長之基礎。

未來，精材將加速研發符合市場趨勢的封裝解決方案，落實誠信創新之企業理念以提供客戶最專業的高價值服務，並持續強化 3D/2D 晶圓級相關先進製程技術的應用，致力本公司穩定成長且為全球客戶最可信賴的晶圓級封裝服務之領導廠商。

董事長：陳健邦  
經理人：林俊吉  
會計主管：林恕敏

精材科技股份有限公司 公鑒：

精材科技股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照會計查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規範並執行查核工作，以確認財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式復取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可表示之意見提供合規之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當審查精材科技股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，精材科技股份有限公司自民國九十八年一月一日起，採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」。

精材科技股份有限公司民國九十九年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供充分分析用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所  
會計師 黃 鴻 文

會計師 林 鴻 鵬

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號  
台財證六字第 0920123784 號

中華民國一〇〇年一月二十一日

(附件四)

精材科技股份有限公司

民國九十九年十二月三十一日

民國九十九年度純益 NTS\$505,260,221

減：  
- 提撥百分之十法定盈餘公積 50,526,022  
- 提撥特別盈餘公積 814,439  
民國九十九年度可分配保留盈餘 453,919,760

加：  
- 以前年度未分配盈餘 627,287,596

截至民國九十九年底可分配保留盈餘 1,081,207,356

分派項目合計 251,708,844

期末未分配盈餘 NTS\$829,498,512

\*附註：  
1.已扣除配發員工現金紅利新台幣 34,043,986 元。  
2.已扣除配發員工股票紅利新台幣 34,043,978 元，發行股數 1,940,992 股。(依最近一期會計師查核之財務報告淨值為計算基礎，計算不足一股之部份以現金方式發放。)  
3.已扣除配發董事及監察人酬勞新台幣 9,078,391 元。  
4.本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響：本公司無須公開民一百年度財務預測資訊，故不適用。

董事會造送本公司民國九十九年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本監察人等查核，認為尚無不合，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請鑑核。

精材科技股份有限公司

監察人 沈維民

董事長：陳健邦  
經理人：林俊吉  
會計主管：林恕敏

監察人 侯政

中華民國一百年四月二十八日



民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

股東權益其他項目

金 融 資 本 準 備 保 留 盈 餘 (附註八及十九)

股 板 本 準 備 未 分 配 盈 餘

(附註八及十九)

股 板 本 準 備 合 變

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,008

\$ 3,461,